**证券代码：605358**  **证券简称：立昂微**

**杭州立昂微电子股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2024-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ●特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □新闻发布会  ●现场参观 ●电话会议  □其他 |
| 参与单位名称 | 2024年6月13日：大家资管  2024年6月17日：天风证券、聚鸣投资、人保资产、西部利得、光大保德信、长江养老、万家基金、汇添富、兴业基金、中庚基金、信达澳亚、泰康资产、华夏久盈、胡朝凤、永赢基金、平安基金、兴全基金、新华资产、招银理财、广发基金  2024年6月18日：中金公司、红杉中国、东方证券、兴全基金、君和资本、中财投资、英大信托、从容投资 |
| 地点 | 线上会议、现场会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云  证券事务代表：李志鹏 |
| 投资者关系活动记录 | 一、公司近期业务概况  （一）硅片业务板块  1. 出货量：公司2024年第一季度的出货量同比和环比均实现大幅增长，第二季度开始呈现出更为乐观的增长趋势，目前6英寸、8英寸外延片产能利用满载，出现交货延迟的情况；12英寸硅片出货量快速爬坡，出货量屡创新高。  2.硅片价格：6-8英寸硅片受产能紧张、产品结构调整等因素的影响，2024年第二季度以来平均出货价格环比上升，产品价格开始进入上升趋势。12英寸硅片价格保持稳定。  3.行业趋势：从今年以来的订单情况来看，半导体硅片细分行业开始见底回升，当前国内硅片的需求旺盛，产能利用率迅速回升。大硅片的国产化替代正在稳步推进，公司12英寸硅片产品爬坡进度有望加快。  （二）功率器件芯片业务板块  目前设备产能约为23.5万片/月，除为部分关键客户预留的专用产能外，最新产品出货已接近满产状态，出货量环比上升。产品价格于2024年第一季度见底，目前在逐步回暖，部分产品的市场价格出现回升。  （三）化合物半导体射频芯片业务板块  1. 技术情况：技术水平进入全球第一梯队行列。开发了二维可寻址VCSEL工艺技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达VCSEL芯片的制造厂商。  2.客户验证情况：射频芯片产品基本覆盖国内主流手机芯片设计客户及其他应用端客户。产品同时进入低轨卫星终端客户实现大规模出货。  3.国产替代情况：受国际形势的影响，射频芯片供应链逐步转向国内，射频芯片国产化替代进度加快。  4.产能情况：杭州基地目前经过扩产，产能约为9万片/年，海宁基地预计可于2024年第四季度投入商业运营，第一期产能约为6万片/年。  5.产能利用率情况：产能利用率同比大幅上升，在手订单同比大幅增长，预计2024年射频芯片产品出货量同比将实现大幅增长。  二、投资者交流主要问题回复  1. 硅片产品中不同规格、不同应用类型的产品中何种类型的景气度更高？  答：不同规格产品中6英寸、8英寸硅片的景气度较高；不同产品用途的硅片中应用于FRD、IGBT等功率半导体产品的硅片景气度最高。因为FRD、IGBT等功率半导体产品需求的外延片属于厚外延产品，单位产品应用更多的产能，该类产品的附加值也更高，因此公司外延片景气度最好。目前公司外延片出货数量占硅片出货总量的70%以上。  2.目前硅片价格相较于前期高点相差多少？  答：公司硅片产品2023年平均出货价格相比2022年下降约12%。  3.公司12英寸大硅片后续规划如何？  答：公司衢州基地12英寸硅片已建成抛光片（衬底片）15万片/月、外延片10万片/月的产能，衢州基地月产15万片12英寸外延片的产能正在建设中；嘉兴基地12英寸硅片规划的整体产能为40万片/月的抛光片，目前已建成5万片/月的产能，预计2024年年底达到15万片/月。嘉兴基地后续25万片/月的产能建设将视前期产能爬坡情况再适时启动。  4.公司生产的硅片是否用于出口，是否受限制？  答：公司生产的硅片可用于出口，出口占比约15%，出口产品主要为重掺硅片，公司重掺硅片产品技术在全球具有竞争力，客户主要来自日本、中国台湾、欧盟、东南亚等地，目前硅片出口未受限制。公司硅片产品的外销价格比内销价格更高，目前公司也正在积极开拓海外客户，提升外销占比。  5.嘉兴金瑞泓何时能达到盈亏平衡吗？  答：嘉兴金瑞泓预计2024年年底建成15万片/月的抛光片产能，据测算，预计出货量（正片）达到全年产能的70%以上可以达到盈亏平衡。  6.射频产品中不同类别客户的营收占比如何？  答：射频产品中与手机有关的营收占比约50%，其他营收产品包括特殊规格多用途芯片、低轨卫星通讯芯片、VCSEL、掩膜版等收入。  7.VCSEL产品目前如何？  答：公司VCSEL产品目前产能为1万片/年，产品广泛应用于消费电子领域的3D 感知、智能家居、激光美容、光通讯和车载激光雷达等。公司开发的二维可寻址VCSEL工艺技术，是行业内首个进入量产的大功率VCSEL技术，能充分适应车载雷达的技术指标需求。 |
| 资料清单（如有） | 无 |